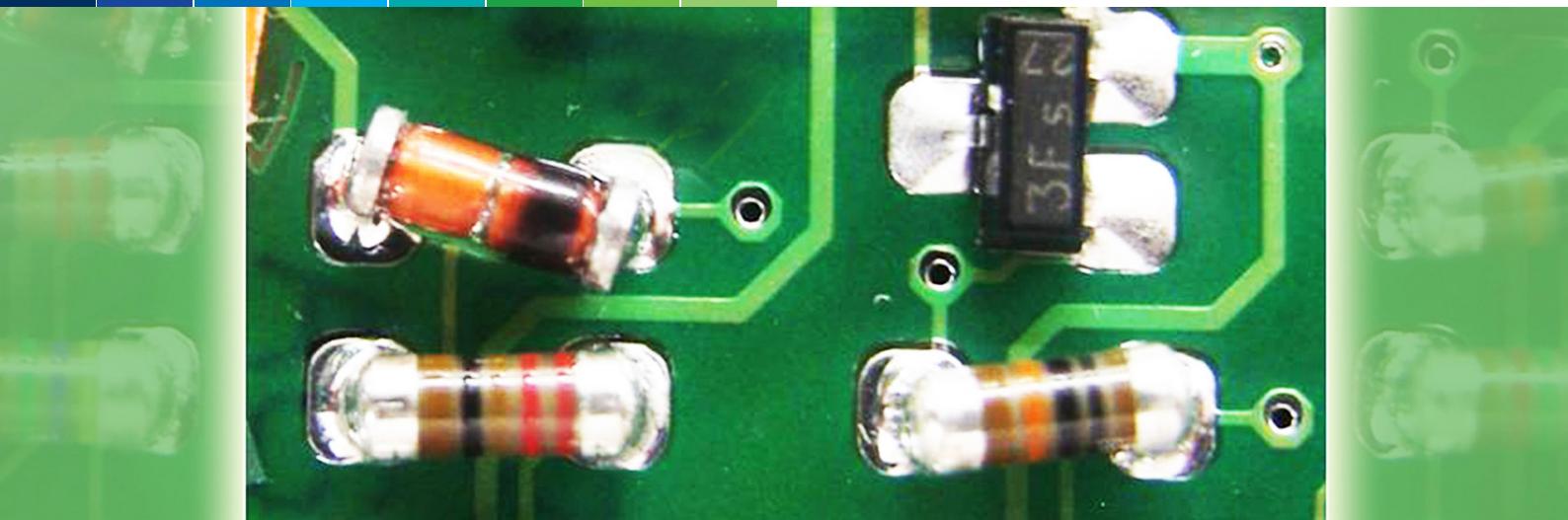


Fehlermanagement in der Elektronikfertigung



31. März 2022, virtuelles Seminar

Seit den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts streben die Elektronikfertiger weltweit eine Null-Fehler-Qualität an. Dennoch scheint das Ziel absolut nicht erreichbar. Neue Aufbau- und Verbindungstechnologien sowie stetig wachsende Bestückdichten und eine größere Bauelementenvielfalt generieren mehr und oft auch neue Fehlerarten. Das Seminar diskutiert viele Ursachen der Entstehung von Lötfehlern und Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung.

Teilnahmegebühr:
395 € inkl. ausgedruckter Schulungsunterlagen

Anmeldungen unter:
www.rehm-group.com/aktuelles/termine

09.00 Uhr	Begrüßung
09.05 Uhr	Whiskers und Black-Pad, Wicking und Graping – Entstehungsmechanismen und Abhilfemaßnahmen
10.00 Uhr	Pause
10.15 Uhr	Solderballs – Material- und Prozesseinflüsse
11.15 Uhr	Pause
11.30 Uhr	XY-Versatz und Selfalignment, Nichtlötungen und Brücken – Ursachen und Vermeidung
12.15 Uhr	Pause
13.00 Uhr	Tombstones – Ursachen und Vermeidung
14.00 Uhr	Pause
14.15 Uhr	Voids – Material- und prozessspezifische Faktoren, Einfluss auf die Zuverlässigkeit
15.15 Uhr	Ende des Seminars

Vorbehaltlich inhaltlicher Anpassungen



TECHNOLOGY ACADEMY